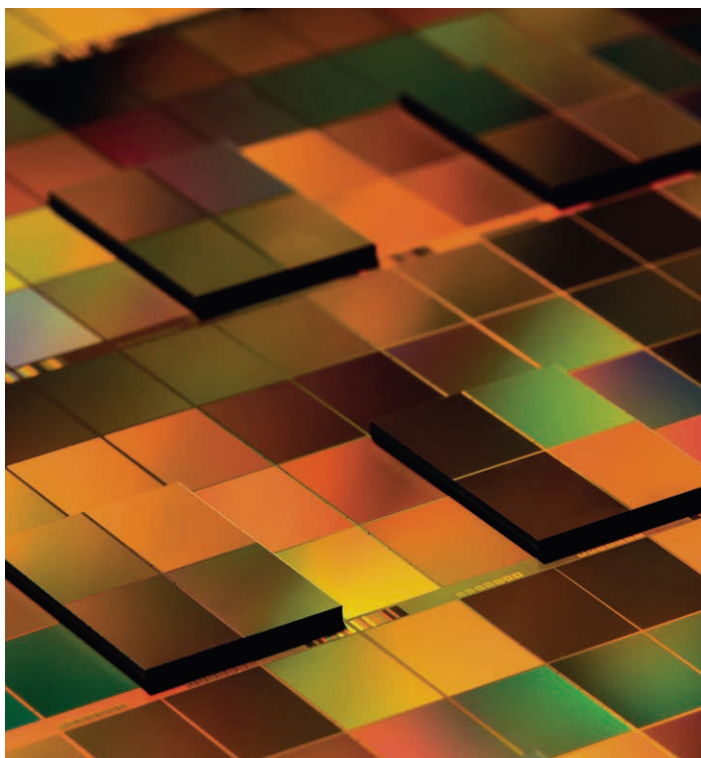




EV GROUP®

ヘテロジニアス・インテグレーション・
コンピテンスセンター™



www.EVGroup.com

EVG ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンセンター™について

EVGのヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンセンターは、お客様がEVGのプロセスソリューションおよびノウハウを活用することで、システム統合とパッケージング技術の進歩により可能となる新製品や機能強化品の開発およびアプリケーションの実現が出来るように設計されています。これらには、ハイパフォーマンス・コンピューティングやデータセンター、IoT (Internet of Things)、自動運転、医療およびウェアラブルデバイス、フォトニクス、先端センサー等に対するソリューションとアプリケーションが含まれます。

EVGは、ヘテロ集積化に関して広範囲に渡る要素技術を有しており、この重要な技術トレンドに対するソリューションを20年以上提供し続けています。これには、永久ウェーハ接合 (3D/パッケージング向けフュージョン/ハイブリッド接合や金属接合を含む) や、ダイ to ウェーハ接合 (一括転写用支持基板あり・なし) によるIII-V族化合物半導体-シリコンの統合あるいは高密度3D/パッケージング、仮接合・剥離技術 (機械式・スライドオフ/リフトオフ・UVレーザー剥離を含む)、薄ウェーハ搬送、革新的なリソグラフィ技術 (マスクアライナー、コーター、ディベロッパー、マスクレス露光/デジタルリソグラフィ等) などがあります。

EVGのHIコンピテンセンターは、お客様やマイクロエレクトロニクスのサプライチェーンを通じて協業するパートナー企業様へ、オープンアクセスなイノベーション・インキュベーターを提供します。そして、私たちが持つソリューションとプロセス技術のリソースを活用することで、ヘテロ集積化によって可能となる革新的なデバイスやアプリケーションの開発サイクルと市場への投入時間の短縮を実現します。



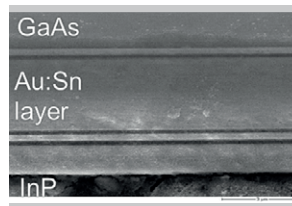
Cleanroom at EVG headquarters

直接接合



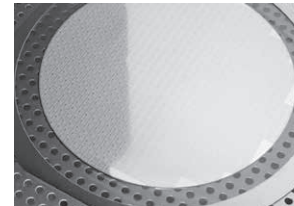
- プラズマ活性化直接接合
- 陽極接合
- ComBond®
- ハイブリッド接合
<100 nm オーバーレイ

金属接合



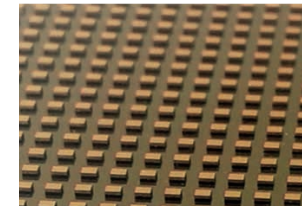
- 共晶接合
- はんだ接合
- 液相界面接合
- 金属熱圧着接合

仮接合



- 接着剤、テープワックス
- スライドオフ
- メカニカル剥離 (ZoneBond®)
- レーザー剥離

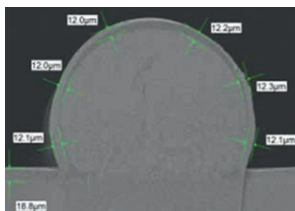
ヘテロジニアス・インテグレーション / C2W



- プロセス統合
- ウェーハレベルダイトランスファー
- 検査・計測

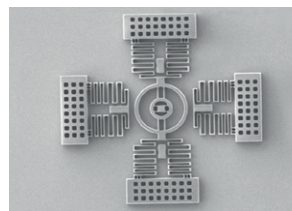
EVG ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンセンター™ オープンアクセス・イノベーションインキュベーター

レジスト処理



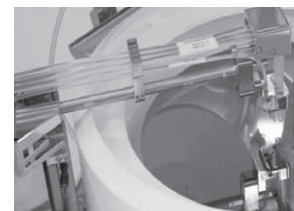
- スピン塗布
- スプレー塗布
- 薄膜 (40nmまで)
- 厚膜フィルム
- エッジ塗布

リソグラフィ



- マスクレス露光
- 近接露光マスクアライナー
- 再配線によるファインピッチ
- バンプ処理
- 新規デバイス要件に合わせてカスタマイズされた露光プロセス

現像



- DI リンス、溶剤
- スプレー
- バドル
- 加熱
- メガソニック

最先端レジスト塗布



- NanoFill™
- NanoSpray™
- カバースピン
- ブラックレジスト
- 量子ドットフィルム
- プラズマダイシング

EV Group

EVGの装置を活用したソリューションと製造プロセスの専門知識の重要性は半導体業界で実証されており、以下を始めとした数多くの主要アプリケーションをサポートしています。

- 最先端パッケージング、3次元積層
- MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)
- SOI(シリコンオンインシュレータ)
- 化合物半導体制およびシリコン製パワーデバイス
- ナノテクノロジー

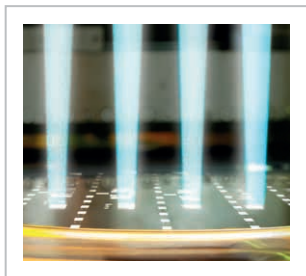
マスクレス露光、フュージョン / ハイブリッドウェーハ接合、そしてその他のプロセスにおけるEVGの近年の開発は、次世代の異種 / 3D積層デバイスの新しい可能性を広げるためのソリューションとなります。

EV Group (EVG) の提供するソリューション:

- ウェーハ接合
- マスクアライナー
- 塗布 / 現像
- 仮接合 / 剥離
- 洗浄
- 検査・計測
- マスクレス露光 / デジタルリソグラフィ



GEMINI® FB XT
全自動量産用ウェーハ接合装置
300 mmまでの基板に対応



MLE™ マスクレスリソグラフィ
従来のマスク露光を超えた、デジタルリソグラフィ技術への進化

EV Group Global Locations Application Laboratories

Headquarters

EV Group
E. Thallner GmbH
DI Erich Thallner Strasse 1
4782 St. Florian am Inn
+43 7712 5311 0
ProcessTechnologySD@EVGroup.com

Japan

EV Group Japan KK
Yokohama Business Park East Tower 1F
134, Godo-cho, Hodogaya-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa, 240-0005
+81 45 348 0665
Technology@EVGroup.jp

North America

EV Group Inc.
7700 South River Parkway
Tempe, AZ 85284
+1 480 305 2400
ProcessUS@EVGroup.com

お問い合わせ

ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンター™
お問い合わせはこちらまで。

イーヴィグループジャパン株式会社

045-348-0665 または e-mail.

Get in touch:

HeterogeneousIntegration@EVGroup.com

Printed on paper from sustainable sources. Data, design and specifications may not simultaneously apply; or depend on individual equipment configuration, process conditions and materials and may vary accordingly. EVG reserves the right to change data, design and specifications without prior notice. All trademarks, logos, website addresses or equipment names are registered trademarks and/or the property of EV Group or their respective owners.

Printed on paper from sustainable sources
© EV Group (EVG). All rights reserved. V22/01 JP based on V22/01



www.EVGroup.com



www.EVGroup.com